

くまもと3D連携コンソーシアム 会員の皆様

第4回産学連携交流セミナー・ ポスターセッション

日時：令和8年8月25日(火)

◆セミナー・ポスターセッション(無料):

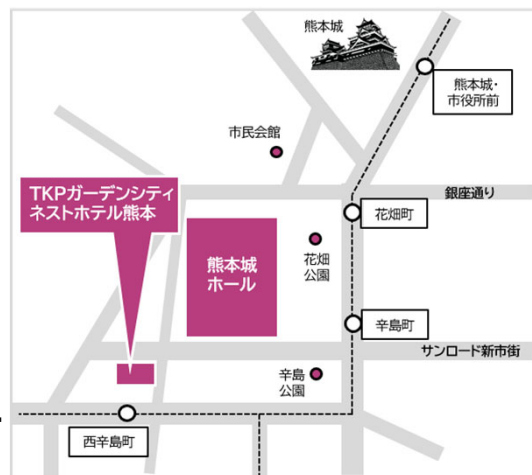
13:00~16:30

会場：熊本城ホール 大会議室

◆交流会(有料・会費5,000円): 17:00~19:00

会場：TKPガーデンシティ ネストホテル熊本・2F

熊本県 熊本市中央区辛島4-39



◆ お申し込み方法

下記のリンクまたはQRコードよりお申し込みください

<https://forms.gle/tLsG1zJyW3bDYj149>

【参加の申し込み：2026年8月10日(月)まで】

お申し込みはこちら



◆ プログラム

1. セミナー
2. 出展者によるリレープレゼン
3. ポスターセッション

◆ セミナー

「内閣府事業で取り組むチップレベル3次元実装プロセス」

講師：熊本大学 半導体・デジタル研究教育機構 准教授 渡辺直也



熊本県では、2023年に、内閣府「地方大学・地域産業創生交付金」に採択され、「半導体産業の強化及びユーザー産業を含めた新たな産業エコシステムの形成」に取り組んでいる。その取り組みの一環で、これまでに、半導体の3次元実装による新産業の創生に向けて、新しい材料・設計技術・プロセス技術・検査技術等が開発されてきた。本年度からは、各技術の成果を一部盛り込んだ「チップレベル3次元実装プロセス」を新規に立ち上げるとともに、それにより微小サイズのIoT (Internet of Things) デバイスを作製する予定である。本講演では、このチップレベル3次元実装プロセスについて紹介する。

◆お問合せ◆

くまもと3D連携コンソーシアム事務局
(熊本大学 研究開発戦略本部 イノベーション推進部門)
E-Mail: kumamoto3d@ku-kico.org